

苏州市科技计划项目验收证书

苏科验字〔2019〕734号

计划类别：重点产业技术创新->重点研发产业化

项目编号：SGC201710

项目名称：12英寸7nm封装测试技术的研究开发

承担单位：苏州通富超威半导体有限公司

主管部门：工业园区科技和信息化局

项目合作单位：

项目负责人：陈传兴

项目组成员：马军、吴平、李文桃、徐一凡、张永新、
董建、吴江雪、张巍、马骅、何志丹、吴辉、范广浩、
章晨杰、徐冬兰、朱军、季洪虎、陈文渊、包仲华、
林健、王静、张岩、吴斌

验收形式：会议验收

验收结论：验收通过

发证日期：

项目验收委员会名单：

姓名	单位	性别	专业	职务或职称
陆卫忠	苏州科技大学	男	计算机软件	副教授
赵鹤鸣	苏州大学电子信息学院	男	电子信息	教授
刘昊	东南大学	男	微电子	技术总监/ 副高级
谢蔚泓	苏州明诚会计师事务所	男	财务	注册会计师
赵策洲	西交利物浦大学	男	微电子学、集成电路	教授

项目验收意见：

受苏州市科技局委托, 2019 年 11 月 25 日苏州工业园区科技和信息化局组织有关专家, 对苏州通富超威半导体有限公司承担的“12 英寸 7nm 封装测试技术的研究开发”（项目编号：SGC201710）项目进行了验收。验收委员会听取了项目汇报，审阅了有关资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1、项目提供的验收资料齐全、规范，符合要求。

2、本项目面向的高端处理器芯片是基于 14nm 工艺封装基础上，首次实现从 14nm 到 7nm 封装工艺的技术跨越，并且完全技术自主可控，研发成果及各项指标均已达到合同要求。项目执行期内，申请发明专利 2 件，授权实用新型专利 3 件、软件著作权 5 件，制订企业技术标准 1 项，开发新产品 17 项。

3、项目累计实现销售收入 4806.43 万元，利税 600.00 万元，出口创汇 699.74 万美元。

4、项目新增投入 2405.80 万元，其中市拨经费 49 万元，企业自筹资金 2356.80 万元。资金到位及时，使用合理。

验收委员会认为，项目已完成合同规定的各项指标，一致同意通过验收。